

2023年03月

电子元器件销售 行情分析与预判



正文目录

序章.....	1
一、3月宏观经济.....	1
1、全球制造业趋稳回升，波动性加大.....	1
2、电子信息制造业下滑明显，持续走低.....	2
3、半导体销售大幅下挫，指数回调.....	3
二、3月芯片交期趋势.....	4
1、整体芯片交期趋势.....	4
2、重点芯片供应商交期一览.....	4
三、3月订单及库存情况.....	6
四、3月半导体供应链.....	7
1、半导体上游厂商.....	7
(1) 硅晶圆/设备.....	7
(2) 原厂.....	8
(3) 晶圆代工.....	9
(4) 封装测试.....	10
2、分销商.....	10
3、系统集成.....	11
4、终端应用.....	12
(1) 消费电子.....	12
(2) 新能源汽车.....	12
(3) 工控.....	13
(4) 光伏.....	14
(5) 储能.....	14
(6) 服务器.....	15
(7) 通信.....	15
五、分销与采购机遇及风险.....	16
1、机遇.....	16
(1) 更上层楼，2026年智能家居设备规模或超2790亿.....	16
(2) 风生水起，2023年全球折叠手机出货量或达1900万台.....	16
(3) 如火如荼，2023年SiC功率器件将突破22亿.....	16
(4) 初露曙光，手机HD版本TDDI芯片价格上涨10%.....	17
2、风险.....	17
(1) 市场低迷，2月智能手机OEM继续进行库存调整.....	17
(2) 砍单杀价，关注车企芯片供应链新变化.....	17

3、政策趋势.....	17
六、小结.....	18
免责声明.....	19

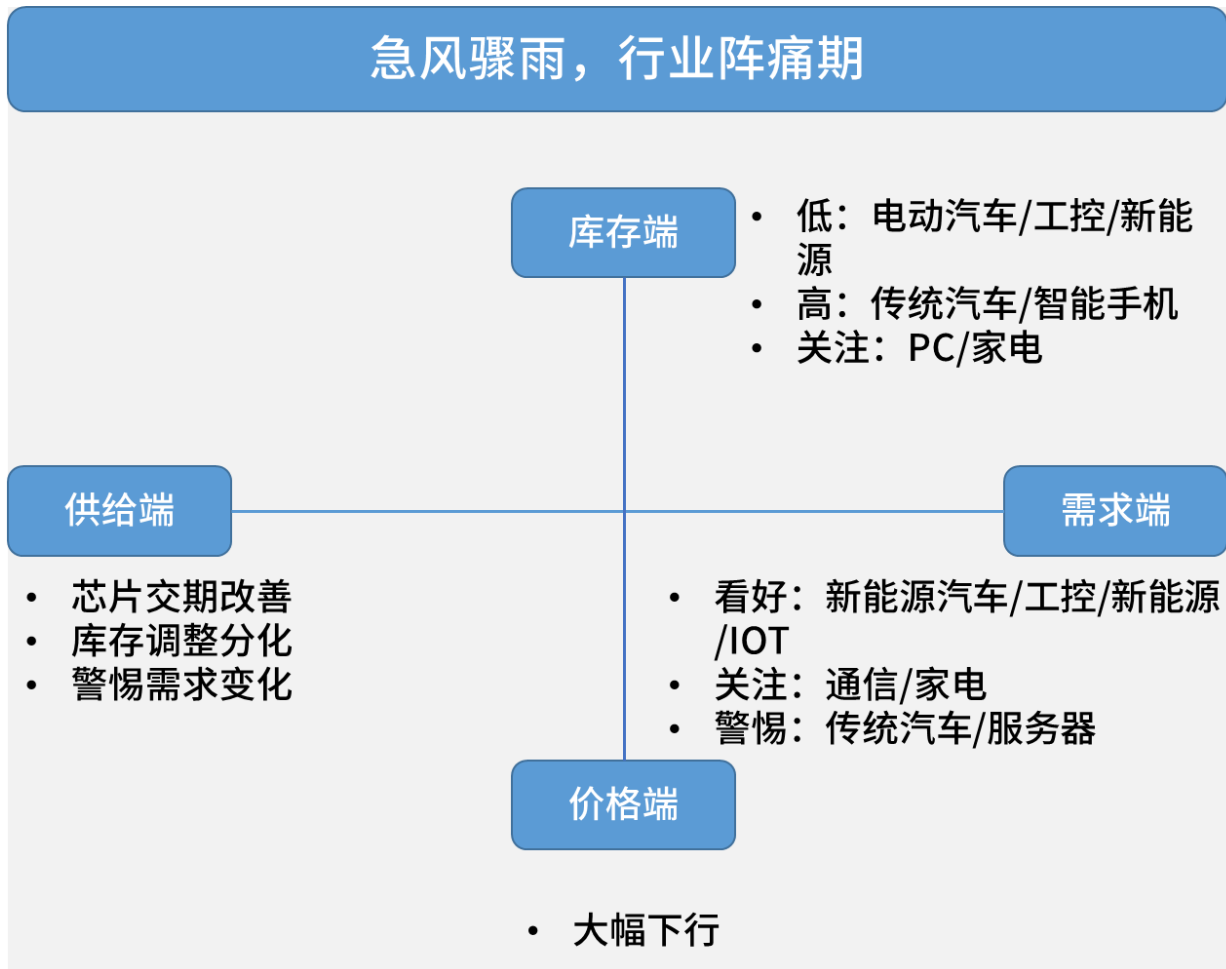


图表目录

图表 1: 3月全球主要经济体制造业 PMI.....	2
图表 2: 2022年2月电子信息制造业运行情况.....	2
图表 3: 2023年1月全球及中国半导体行业销售额增速对比.....	3
图表 4: 3月费城及申万半导体指数走势.....	3
图表 5: 3月芯片交期趋势.....	4
图表 6: 2023Q1 主要交期下降的厂商及品类一览	5
图表 7: 3月头部企业订单及库存情况	6
图表 8: 3月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况.....	8
图表 9: 3月主要原厂最新动态	8
图表 10: 3月主要晶圆代工厂最新动态	9
图表 11: 3月主要封测厂商动态情况.....	10
图表 12: 3月主要元器件分销商最新动态.....	10
图表 13: 3月主要系统集成商最新动态	11
图表 14: 3月消费电子厂商最新动态	12
图表 15: 3月新能源汽车厂商最新动态	13
图表 16: 3月工控厂商最新动态	13
图表 17: 3月光伏厂商最新动态	14
图表 18: 3月储能厂商最新动态	14
图表 19: 3月服务器厂商最新动态.....	15
图表 20: 3月通信厂商最新动态	15
图表 21: 3月元器件领域重点政策一览	18



序章



一、3月宏观经济

1、全球制造业趋稳回升，波动性加大

3月，全球经济有所回调，但除中国外，包括美国、欧盟及日本等主要经济体仍处低位，趋稳态势仍待观察。

图表 1: 3月全球主要经济体制造业 PMI



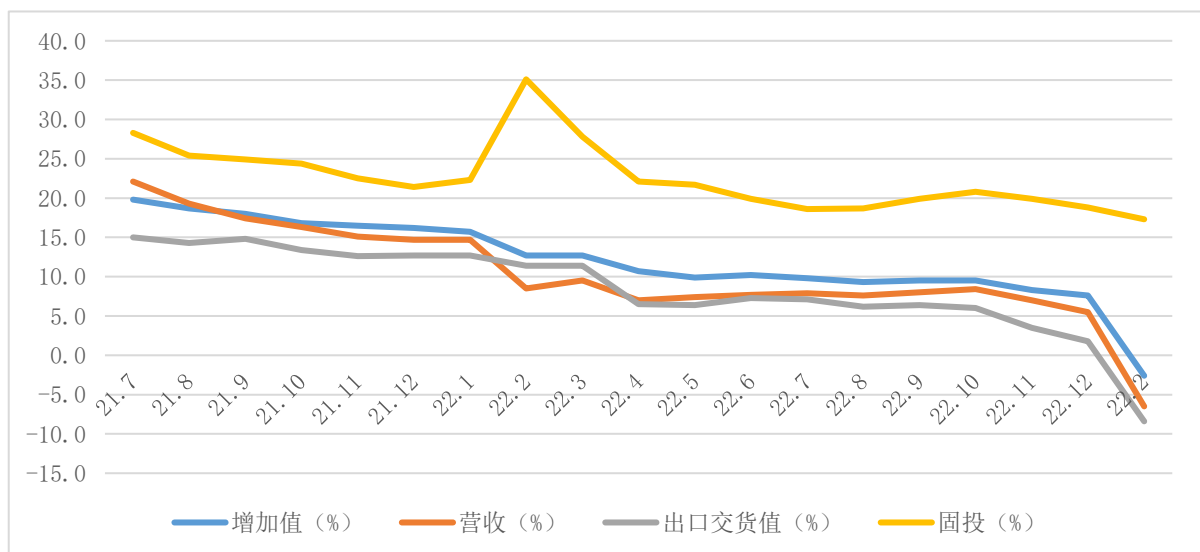
资料来源: 国家统计局

疫情不再是影响世界经济复苏主要因素，受制于地缘政治冲突影响，全球产业链和供应链稳定性仍不牢固，普遍性通胀对经济的影响加剧。

2、电子信息制造业下滑明显，持续走低

1-2月，电子信息制造业生产规模同比小幅收缩，出口呈下降态势，企业效益下滑明显，投资保持较快增长。

图表 2: 2022年2月电子信息制造业运行情况

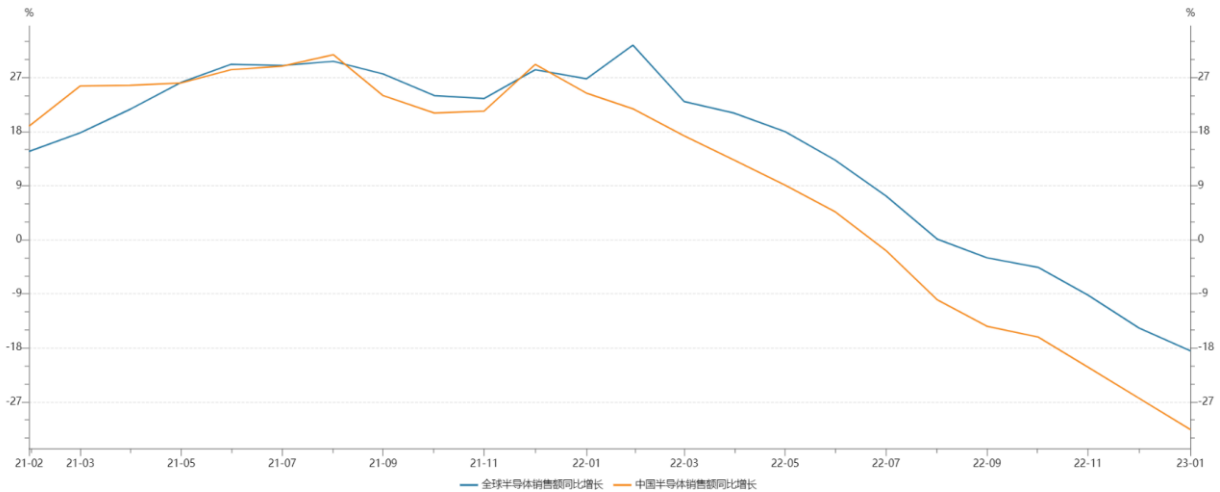


资料来源: 工信部、芯八哥整理

3、半导体销售大幅下挫，指数回调

2023年1月，根据最新调整数据，全球半导体行业销售同比下降18.5%，中国市场同比下跌31.6%。半导体行业已进入了周期性衰退。

图表 3：2023年1月全球及中国半导体行业销售额增速对比



资料来源: SIA、芯八哥整理

从资本市场指数来看，3月费城半导体指数(SOX)上涨9.3%，中国半导体(SW)行业指数回调6.04%。受供应链回暖影响，市场信心短暂回升。

图表 4：3月费城及申万半导体指数走势



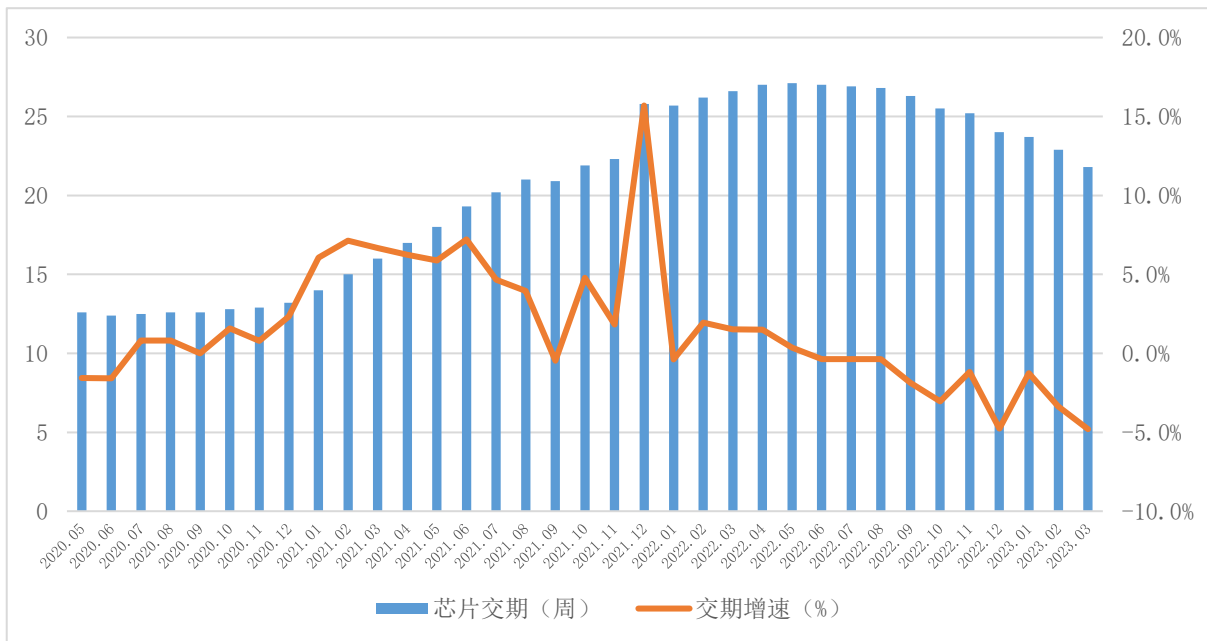
资料来源: Wind

二、3月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

3月，全球芯片交货周期从2022年5月高点持续滑落，累计缩短交期超过一个月，种种迹象表明，持续两年多的缺芯危机有望结束。

图表 5：3月芯片交期趋势



资料来源: Susquehanna Financial Group

2、重点芯片供应商交期一览

从最新 Q1 各供应商看，博通、三星、SK 海力士等消费料厂商库存处于高位，Microchip、ST 和 NXP 等应用广泛的厂商交期下降明显，Infineon 及安森美等厂商整体交期趋稳。细分品类方面，多数车规级芯片交期改善，消费类产品随着库存去化行情有回转态势。

图表 6: 2023Q1 主要交期下降的厂商及产品一览

厂商	产品	23Q1 交期/周	交期趋势	价格趋势
ST	传感器	12-24	下降	稳定
	放大器和数据转换器	28-40	下降	稳定
	蓝牙模块	20-25	下降	稳定
	晶闸管/Triac	30-40	下降	稳定
	8 位 MCU	35-52	下降	稳定
	汽车	40-52	稳定	稳定
	32 位 MPU	16-20	下降	稳定
	STM32FO	16-20	下降	稳定
	STM32F1	16-20	下降	稳定
	STM32L	16-20	下降	稳定
On semi	放大器和数据转换器	26-42	下降	稳定
	低压 MOSFET	36-52	下降	上升
	逻辑器件	20-30	下降	稳定
Infineon	蓝牙模块	26-36	下降	稳定
	低压 MOSFET	26-54	下降	稳定
	32 位 MCU	26-52	下降	稳定
NXP	8 位 MCU	35-52	下降	稳定
	32 位 MCU	26-52	下降	稳定
	32 位 MPU	32-52	下降	稳定
瑞萨	开关稳压器	36-40	下降	上升
	8 位 MCU	40	下降	上升
	32 位 MCU	40	下降	上升
Microchip	FPGA	32-52+	下降	稳定
	WiFi 模块	24-26	下降	上升
	8 位 MCU	36-52+	下降	上升
	32 位 MCU	36-52+	下降	上升
Diodes	低压 MOSFET	26-54	下降	稳定
	TVS 二极管	18-24	下降	稳定
	桥式整流器	14-32	下降	稳定
	肖特基二极管	14-52	下降	稳定

厂商	产品	23Q1 交期/周	交期趋势	价格趋势
	齐纳二极管	16-45	下降	稳定
	双极晶体管	14-45	下降	稳定
	数字晶体管/RETS	14-45	下降	稳定
	通用晶体管	14-45	下降	稳定
	逻辑器件	30-40	下降	稳定
村田	蓝牙模块	26-50	下降	稳定
	滤波器	16—20	下降	稳定
	引线陶瓷电容	16—18	下降	稳定
	专用电容	16—18	下降	稳定
安世	肖特基二极管	8-50	下降	稳定
	开关二极管	8-50	下降	稳定
	小信号 MOSFET	12-50	下降	稳定
	齐纳二极管	8-50	下降	稳定
	双极晶体管	8-50	下降	稳定
	数字晶体管/RETS	8-50	下降	稳定
	通用晶体管	8-50	下降	稳定
SK 海力士	NAND 闪存	8—12	下降	根据市场调整
	eMMC	8—12	下降	根据市场调整
金士顿	eMMC	4—10	下降	根据市场调整
	固态驱动器(SSD)	4—8	下降	稳定

资料来源：富昌电子、芯八哥整理

三、3月订单及库存情况

从企业订单及实际库存情况看，消费类厂商订单和库存有所回调，价格有所松动；车规料供给和价格趋于稳定。

图表 7：3月头部企业订单及库存情况

公司	3月订单情况	3月库存情况	2023Q2 定价趋势
Intel	稳定	一般	根据市场调整
AMD	稳定	一般	稳定
三星	下降	一般	稳定
TI	稳定	低	根据市场调整

公司	3月订单情况	3月库存情况	2023Q2 定价趋势
ST	稳定	低	根据市场调整
ADI	稳定	低	稳定
高通	下降	一般	根据市场调整
博通	下降	一般	下降
NXP	上升	低	上升
Infineon	上升	低	上升
瑞萨	稳定	低	根据市场调整
On Semi	上升	无	上升
Microchip	稳定	一般	稳定
镁光	下降	一般	下降
SK 海力士	下降	一般	下降
村田	下降	低	稳定
联发科	下降	一般	下降

注：高>较高>一般/稳定>较低>低>无

资料来源：芯八哥整理

四、3月半导体供应链

消费料库存去化改善，在传统汽车库存去化下，车规料产品有明显好转，行业景气度回转虽缓但稳。

1、半导体上游厂商

(1) 硅晶圆/设备

3月，设备需求一定跌幅，关注荷兰将加码限制影响；受代工需求影响，硅晶圆恐面临新的震荡调整。

图表 8：3月半导体设备及硅晶圆头部企业订单情况

类型	企业	3月订单	3月库存	2023Q2 订单预测
设备	ASML	稳定	低	根据市场情况调整
	AMAT	稳定	低	稳定
	泛林	稳定	低	根据市场情况调整
	TEL	稳定	低	稳定
	科磊	稳定	低	根据市场情况调整
	北方华创	稳定	低	上升
	中微公司	稳定	低	上升
硅晶圆	信越化学	下降	一般	下降
	Sumco(胜高)	下降	一般	下降
	环球晶圆	下降	较高	下降
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降
	沪硅产业	稳定	一般	下降

资料来源：芯八哥整理

(2) 原厂

3月，主要厂商已过库存调整高峰期，景气度有所回转，重点扩产车规级应用。

图表 9：3月主要原厂最新动态

厂商	3月动态
Intel	发布至强处理器路线图，Intel 20A、Intel 18A 测试芯片已流片
AMD	三星计划开发基于 AMD RDNA 架构移动 GPU
英伟达	将向亚马逊和谷歌云业务提供下一代 AI 芯片
TI	成都第二座封装/测试厂（CDAT2）预计年内投产
高通	汽车芯片研发中心落地成都，看好中国经济前景
三星	半导体业务 1-2 月已亏损 3 万亿韩元
联发科	部分驱动 IC 调涨 10-15%
博通	考虑将 Intel 作为潜在代工伙伴
ADI	与德科技合作设计和开发 6G 技术
ST	2025 年 MCU 的 12 英寸产能将增长 1 倍

厂商	3月动态
Infineon	与联电签订 40 纳米 MCU 芯片长期合作协议；2027 年碳化硅产能增加 10 倍
NXP	2023 年汽及工业领域芯片需求将继续增长
瑞萨	宣布收购 NFC 公司 Pantronics
On Semi	与宝马汽车签署 Elite SiC 芯片长期供货合同
Microchip	在俄勒冈州投资 8 亿美元扩产，MCU 及模拟产品产能将提高三倍
东芝	接受 JIP2 万亿日元收购要约
苹果	采用台积电 3nm 制程的自研 5G 基带芯片 2024 年问世
镁光	客户库存情况好转
Rapidus	或投资 5 万亿日元开发 2nm 技术
SK 海力士	寻求美国延长对华芯片出口管制豁免一年
Marvell	在美裁员 320 人，以应对行业放缓
索尼	与三星电子商讨半导体供应合作方案
村田	法国卡昂新建一条 200mm 晶圆生产线
太阳诱电	八幡 MLCC 材料钛酸钡新工厂完工
国巨	产品价格回稳，标准品产能利用率约 40%~50%
华为	基本实现了 14nm 以上 EDA 工具国产化
长江存储	全球 NAND 闪存市场将在下半年达到供需平衡
弗迪科技	布局毫米波雷达赛道
豪威	购芯力特，加码汽车半导体业务
兆易创新	与中金资本联合发起 5 亿元新基金

资料来源：芯八哥整理

(3) 晶圆代工

3 月，车规料号也面临砍单与降价压力，成熟制程最高降价 20%，代工侧已成为新的暴风圈。

图表 10：3 月主要晶圆代工厂最新动态

厂商	3月产能利用率	3月动态	2023Q2 价格趋势
台积电	70%-90%	五大客户库存调整进度不如预期；2月营收环比下降 18.4%；欧洲设厂进度放缓	下降
三星	85%<	成熟制程降价 10%	下降
联电	70%	Q1 订单能见度偏低	稳定

厂商	3月产能利用率	3月动态	2023Q2 价格趋势
中芯国际	70%-80%	下半年订单会有恢复，但价格不一定会同期回升	下降
格芯	85%<	谨慎关注市场变化	稳定
世界先进	50%-60%	2023年资本支出估约100亿新台币，同比下降48%	下降
力积电	60%左右	有条件的与客户进行协商调价	下降

资料来源：芯八哥整理

(4) 封装测试

3月，受上游减产及下游去库存影响，行业仍处于下行阶段。

图表 11：3月主要封测厂商动态情况

厂商	3月产能利用率	3月动态	23Q2 订单预测
日月光	80%<	推出最先进的扇出型堆叠封装（FOPoP）解决方案	下降
长电科技	80%左右	集成电路及模块封装项目部分产线开始小批量验证生产	下降
通富微电	80%-90%	AMD 订单占比超 80%，营收占比 54.15%	下降
华天科技	80%<	拟实施先进封测研发及产业化项目	下降
气派科技	80%-90%	MEMS 封装产品已进入量产阶段	下降
中小封测厂	40%-60%	或迎来兼并重组热潮	下降

资料来源：芯八哥整理

2、分销商

3月，分销商库存呈现下降走势，大多数产品类别的货期显著缩短。

图表 12：3月主要元器件分销商最新动态

厂商	3月动态
艾睿	与高通在 AI 应用达成战略合作
安富利	高压快充是新能源汽车未来方向

厂商	3月动态
大联大	受益于通信、服务器、自动化及汽车需求，2022 营业净利 147 亿
贸泽电子	与 Xvisio Technology 签订全球分销协议
富昌电子	大多数产品类别的货期显著缩短
中电港	证监会同意 IPO 注册
雅创电子	拟收购威雅利 17.12%股份
好上好	境外采购占采购总额的比重逐年降低
英唐智控	电磁驱动型 MEMS 振镜具备量产条件
力源信息	北斗导航相关业务主要来自代理村田、罗姆等产品

资料来源：芯八哥整理

3、系统集成

3月，工控需求维持稳定；传统汽车降价去化加速；消费电子需求有所分化。

图表 13：3月主要系统集成商最新动态

类别	厂商	3月动态
工控	ABB	中国机器人和自动化需求有极大增长空间，机器人密度到 2025 年翻倍
	西门子	与天能电池签署战略合作协议
	施耐德电气	在华第五大研发中心在无锡开幕，聚焦自动化
	汇川技术	PLC 是公司工业自动化业务战略产品
	罗克韦尔	收购服务和解决方案商 Knowledge Lens
汽车	现代摩比斯	重点关注自动驾驶、智能座舱、机器人半导体等领
	麦格纳国际	计划投资 1 亿美元新建座椅工厂，为通用供货
	博世集团	新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地在苏州奠基
	华为	2022 年智能汽车业务收入 22 亿元
	法雷奥	辅助驾驶订单暴增，将继续加大在华投资
	采埃孚	2022 年采埃孚中国销售额达 77 亿欧元，同比增长 10%
	博格华纳	5 亿美元投资 Wolfspeed
消费电子	闻泰科技	或接到三星 2500 万部手机及 2000 万部平板订单
	华勤技术	发起设立基金签约落户吴江汾湖，规模 20 亿元
	立讯精密	中长期目标是成为汽车零部件 Tier 1
	歌尔股份	部分光学模组产品可应用于汽车电子领域
	鸿海	将在印度特伦甘纳邦建新电子厂

类别	厂商	3月动态
	和硕	计划在印度开设第二座工厂

资料来源：芯八哥整理

4、终端应用

(1) 消费电子

审慎评估消费电子复苏,预计2023年全球智能手机、PC和平板出货量分别下降1%、11.2%。

图表 14：3月消费电子厂商最新动态

类别	企业	3月动态
智能手机	苹果	1-2月超过三星成为全球出货量最大的手机厂商
	三星	今年智能手机出货量达不到去年水平
	华为	消费终端业务下行趋势放缓
	小米	2022年智能手机业务毛利率由2021年的11.9%降至9%
	OPPO	收缩德国和英国业务
	联想	拯救者手机放弃,仅保留摩托罗拉业务
	魅族	联手吉利打造“手机+汽车”融合
	荣耀	折叠屏手机在今年下半年较去年有翻倍增长
	Vivo	将整合旗下iQOO,开启降本增效
PC	联想	2022年营收4837亿元,净利润同比下降约80%
	惠普	英特尔将全面退出PC基频芯片,惠普委外发包订单洗牌
	华硕	PC库存已经开始下降
	戴尔	PC库存有所增加
VR/AR	Meta	会继续发展元宇宙
	歌尔	推出XR业内首个一站式音频解决方案
	苹果	AR/VR设备量产将延后至Q3中后期

资料来源：芯八哥整理

(2) 新能源汽车

锂电上游碳酸锂价格逼近成本线,叠加2023年新能源汽车继续免征车辆购置税政

策，行业景气度看好。

图表 15：3月新能源汽车厂商最新动态

厂商	3月动态
比亚迪	2023年新能源汽车继续免征车辆购置税
特斯拉	2023年新能源汽车继续免征车辆购置税
现代	与三星电子签订半导体委托设计、代工合约
大众	新能源汽车样板基地落户佛山，多款新能源车型将投产
宝马	与安森美签署 Elite SiC 芯片长期供货合同
奔驰	中国将是未来 10 年增长最快的市场之一，继续扩大在华投资
丰田	与海马汽车就氢能发展签署战略合作协议
广汽埃安	与华为合作项目变自主开发
吉利	2023年新能源销量相比 2022 年翻番
奇瑞	官降最高 9000 元
蔚来	第三代换电站计划 4 月初正式投入使用
小鹏	P7i 电控由汇川技术独家供应
理想	累计交付已经超过 30 万辆
腾势	3 月 1 日起腾势 D9 上涨 6000 元
小米	汽车完成冬季测试
上汽	拟设立 40 亿元基金，聚焦半导体、新能源领域

资料来源：芯八哥整理

(3) 工控

3月，工控自动化行业随着下游需求释放同步回暖，需求呈现稳定上升态势。

图表 16：3月工控厂商最新动态

厂商	3月动态
施耐德	将在匈牙利投资 160 亿建设新厂
三菱电机	将在日本建造新的半导体工厂
霍尼韦尔	获中国商飞优秀质量奖
信捷电气	公司业务涉及智能制造
英威腾	工业自动化业务占比在 60%以上，低压变频器占主要份额

厂商	3月动态
禾川科技	机器人领域重点客户为拓斯达、新时达、埃夫特等
埃斯顿	工业机器人产品与外资品牌产品整体价差在15%-30%
汇川技术	2022年工业机器人销售订单实现50%以上的增长
新时达	公司以运动控制技术为核心
麦格米特	充电桩领域具备整机生产能力

资料来源：芯八哥整理

(4) 光伏

3月，海外光伏应用市场保持较高需求，以德国为代表的欧洲市场求呈现加速态势。

图表 17：3月光伏厂商最新动态

厂商	3月动态
阳光电源	全球累计开发、建设光伏/风力发电站超2500万千瓦
天合光能	完成可转债募资88.65亿元
锦浪科技	产能利用率饱满
固德威	产品聚焦欧洲市场为主
英威腾	去年公司光伏业务以国内为主，今年前两个月国内和海外占比各一半
德业股份	年产68万套逆变器系列产品项目延期
古瑞瓦特	2022年公司光伏逆变器出货量为930520台
正泰电器	投资新设光伏公司，注册资本8000万
特变电工	加速户用逆变器研发

资料来源：芯八哥整理

(5) 储能

预测2023年储能装机规模100GWh，与2022年相比市场规模翻倍，增速远高于光伏市场。

图表 18：3月储能厂商最新动态

厂商	3月动态
阳光电源	签订英国825MWh储能大单

厂商	3月动态
科士达	公司大部分出货都集中在下半年
上能电气	储能变流器市场出货量再登中国第一
科陆电子	储能业务主要应用于电网和工商业等B端市场
中天科技	前两月储能订单超21亿元
禾迈股份	5000万新设能源技术子公司
德业股份	2022年储能逆变器出货量达30万台，同比暴增677%
英威腾	主要聚焦分布式光储逆变器
固德威	小功率储能PCS领域出货量获得全球第一
古瑞瓦特	2022年公司储能系统出货量为555,764套

资料来源：芯八哥整理

(6) 服务器

3月，行业增速低于预期，包括亚马逊、Meta、Google、微软都将下调采购量。

图表 19：3月服务器厂商最新动态

企业	3月动态
宁畅	三大液冷服务器生产基地年产能超过18万台
浪潮	牵头发布服务器液冷冷板标准
新华三	新华三剩余股权收购今年内希望能完成
戴尔	仍待解决在ODM与仓储的半成品
HPE	调降ODM的主板生产

资料来源：芯八哥整理

(7) 通信

6G技术研发将全面推进，未来三到五年将是关键技术突破窗口期。

图表 20：3月通信厂商最新动态

企业	3月动态
华为	2022年ICT基础设施业务3540亿元
中兴通讯	2022年中公司5G基站、5G核心网、光传输200G端口发货量均全球第二

企业	3月动态
思科	2022年全球SP路由器和交换机市场排名第一
诺基亚	2022年全球5G专利占7.6%
爱立信	2022年仍是中国以外市场的前三大供应商，占约18%的市场份额

资料来源：芯八哥整理

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

(1) 更上层楼，2026年智能家居设备规模或超2790亿

随着技术变革+政策扶持+产业升级下，预计2026年全球智能家居设备市场规模将超2790亿美元。中国已成为全球最大的智能家居生产国，年出货量约2.2亿台，占据全球50%~60%的智能家居市场份额。细分品类看，安全监控和智能照明将成为引领智能家居市场发展重点品类。重点关注厂商包括苹果、三星、华为及小米等。

(2) 风生水起，2023年全球折叠手机出货量或达1900万台

据不完全统计，2023年包括三星、华为等多个品牌将会有37款可折叠手机上线，预估全年全球可折叠智能手机的出货量将达到1900万台，折叠面板出货量将超过2200万片，产量超过2000万台。重点关注面板及芯片厂商三星、京东方、天马及Magna、集创北方等。

(3) 如火如荼，2023年SiC功率器件将突破22亿

据统计，2022年，SiC功率器件主要应用在电动汽车及新能源等领域，市场规模分别为10.9、2.1亿美元，占比约67.4%和13.1%。2023年，随着ST、安森美、英飞凌及比亚迪半导体等在汽车、新能源领域项目明朗化，将推动整体SiC功率元件市场规模达22.8亿美元，同比增长41.4%。重点关注ST、安森美、英飞凌及比亚迪半导体等国内外头部模块厂商进展。

(4) 初露曙光，手机 HD 版本 TDDI 芯片价格上涨 10%

3 月初以来，主流手机市场的 HD 画质 TDDI 芯片报价已上涨一成，这是 IC 设计厂历经 2022 年下半年以来库存调整后的首见报价调涨。据悉，HD 版本 TDDI 供不应求应该会延续至 4 月，等 5 月产能供应恢复正常，价格可能回复正常。重点关注敦泰、联咏、奇景光电和韦尔等厂商。

2、风险

(1) 市场低迷，2 月智能手机 OEM 继续进行库存调整

2 月，全球智能手机出货量(批发)和销量(零售)分别同比下降 11%和 5%。尽管数字有所下降，但智能手机市场从 1 月开始有所改善。2 月行业总库存差额/变化仍为负，表明 2 月主要 OEM 仍处于库存调整状态。具体企业方面，三星、小米、荣耀及 OV 存在一定的库存优化空间，谨慎关注其供应链变化风险。

(2) 砍单杀价，关注车企芯片供应链新变化

近期，国内市场有超过 40 个汽车品牌、100 款左右车型启动降价促销，车企降价抢市影响到车用芯片产业，对供应链砍单与杀价态势更趋白热化。此外，由于传统汽车开始削减订单，电源管理 IC、MOSFET、MCU 等原本火热的车规级产品开始面临价格调整风险。

3、政策趋势

本月，谨慎关注地缘政治冲突对芯片产业供应链影响；新能源汽车供应链成为各国关注焦点。

图表 21: 3月元器件领域重点政策一览

地区	政策/动态	具体内容	影响厂商/供应链
欧盟	撤回 2035 年燃油车销售禁令	维持欧洲在汽车及供应链领域竞争力	大众、宝马、奔驰及博世、大陆、法雷奥等
美国	有关国家的芯片支出“护栏”规则	对中国等国家在芯片、半导体设备领域技术实施限制	Intel、台积电、三星、格芯及 ASML、AMAT、泛林、科磊等
日本	宣布取消对韩半导体技术出口限制	解除日本对韩国的半导体原材料等 3 项物资的出口限制	三星、SK 海力士等
	限制 23 种半导体设备出口	中国芯片制造设备进口受限	中芯国际、华虹、华润微及中微公司等
荷兰	加码限制先进处理器芯片的制造设备出口	中国光刻机进口受限	
韩国	打造半导体产业集群	到 2026 年拟投资 4220 亿美元用于从芯片到电动汽车的关键技术	三星、LG、SK 海力士及现代汽车等
广东	《广东省推进招商引资高质量发展若干政策措施》	重点引进半导体等 20 个战略性新兴产业集群项目	聚焦半导体制造等产业集群
深圳	《市工业和信息化局关于智能传感器产业专项扶持计划实施细则(征求意见稿)》	深圳公开征求智能传感器产业专项扶持计划意见	打造智能传感器产业集群

资料来源: 芯八哥整理

六、小结

3月,从需求侧看,以消费类为代表的终端需求处于去库存的最后阶段,行业库存调整高峰已过,客户库存已正常化;供给侧方面,主要厂商已进行供给调整,分销商库存也急剧下降,预计Q2开启复苏。综上,虽然整体数据仍较悲观,但相对2022Q4已有好转迹象。

免责声明

本文由芯八哥®内容团队整理，观点仅代表作者本人，芯八哥®对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本刊提醒读者，本报告内容及观点仅供学习参考，不构成任何投资及应用建议，请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

深圳华强电子网集团股份有限公司

2023年04月

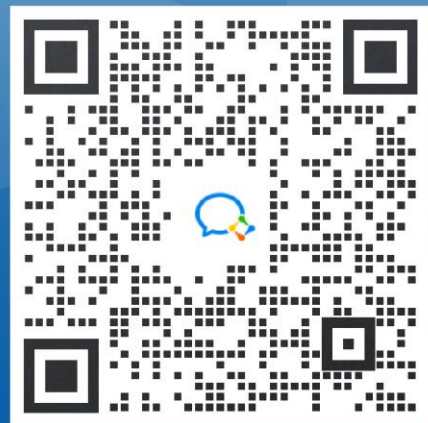


<<< 扫码关注“芯八哥”

及时获取更多半导体市场采购及销售情报、
厂商动态和行业趋势报告

加入芯八哥半导体行业交流群 >>>

群内每日分享行业前沿资讯，还有精品报告、
行业白皮书免费领取





更高效 更透明 重构产业生态

仓储服务 元器件采购 信息服务 API/FTP
PCB制板 BOM工具 SAAS

www.hqewgroup.com

深圳总部

电话：86-755-83396000

传真：86-755-26421633

地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦
B座4、7、9、12楼